



电子技术与工艺训练

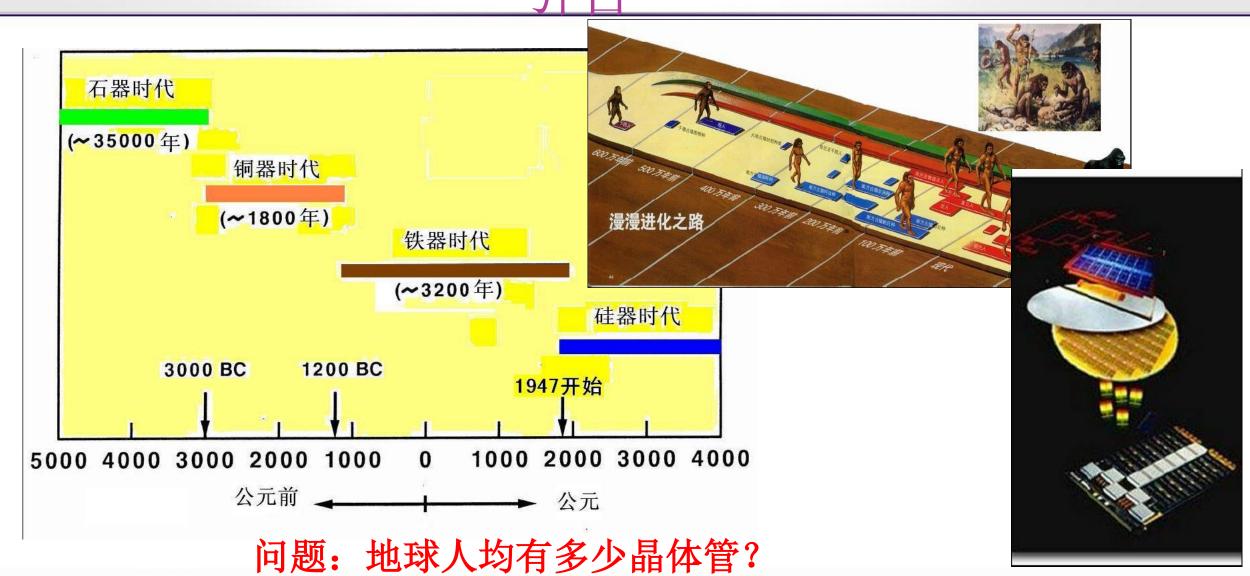
——电子工艺概述

Engineering Training Center, Harbin Engineering University













1.1 什么是电子工艺?

玉不琢 不成器

工艺: 是生产者利用生产设备和生产工具,对各种原材料、半成品进行加工或处理,使之最后成为符合技术要求和产品的艺术(程序、方法、技术)。



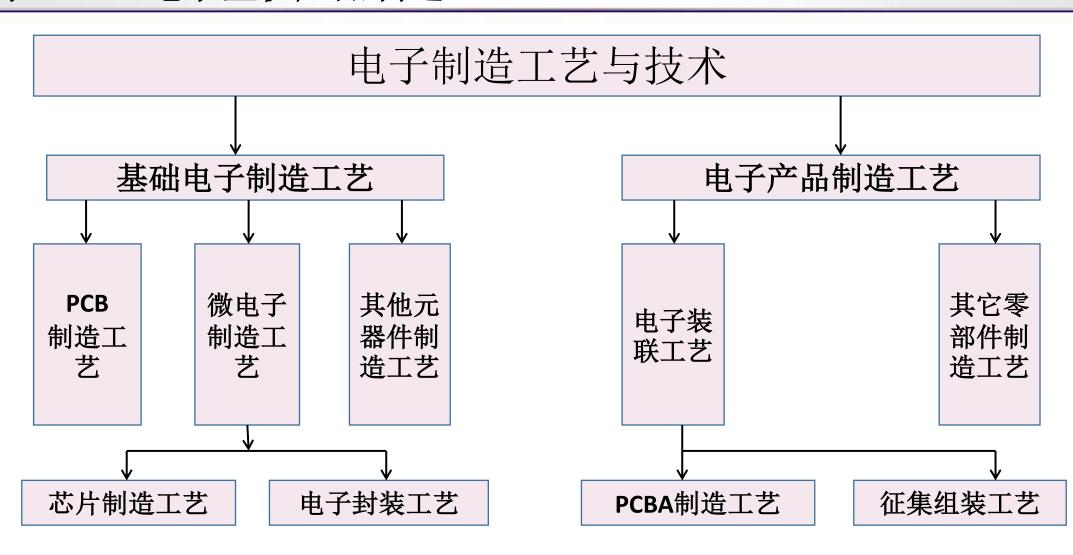
是人类在生产中不断积累起来的并经过总结的操作经验和技术能力。





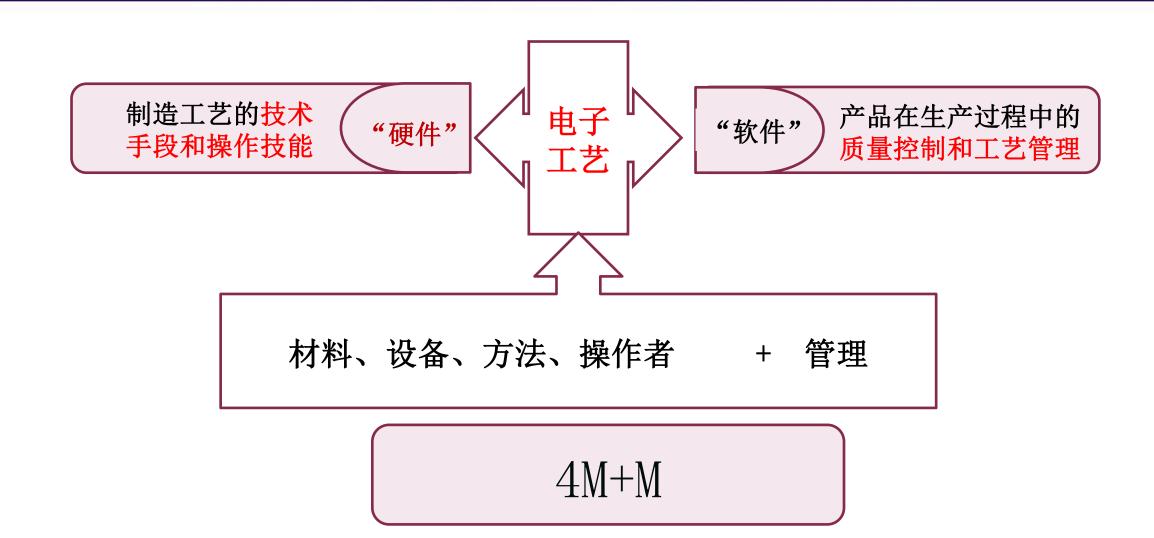


电子工艺: 电子整机产品制造工艺













材料 (Material)

- 包括电子元器件、导线类、金属或非金属材料、零部件、结构件
- 以微处理器为核心的集成电路技术是信息产业的核心技术之一,世界上最先进的技术都 集中在IC芯片中。

集成电路在电子整机中的价值已经从1987年的10%,上升到1995年的13%,1998年的16%,目前约23%。

•不仅如此,集成电路在现代国防及未来战争中也具有重要地位。

| 军舰 | 战车 | 飞机 | 导弹 | 航天器 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22% | 24% | 33% | 45% | 66% |





设备 (Machine)

- 电子产品制造过程中使用各种工具、工装、仪器、仪表、机器、设备等。
- 电子产品工艺技术的提高,产品质量和生产效率的提高,主要依赖于生产设备 技术水平和生产手段的提高。





方法 (Mathod)

- "方法"都是至关重要的——对电子材料的利用、对工具设备的操作、对制造过程的安排、对生产现场的管理。
- 作业的标准化、规范化(装配、检验与测试指导书)。
- 过去,电子产品的生产方法比较简单,对于操作者来说,主要表现为个人的经验 和技能, "手巧"是对他最高的评价。
- 如今,电子产品制造早已不是个人行为,而是现代化管理体系下团队合作的产物。





人力 (Manpower)

- 电子工业是劳动密集型产业、劳动力众多、吸纳大量不同层次人员的就业、担任重要工作岗位的人员应接受足够的教育和训练。
- 我国电子工业历经多年的改革开放,逐渐成为了"世界电子产品制造业的加工厂"。
- 我国电子产品制造业要从"来料加工型"全面转变为"设计制造型",劳动者素质低下就成为发展的瓶颈。
- 我国制造业与西方工业发达国家的差距在人才,其一是高级管理人员,其二是高级 工程技术人员,其三是高等级技术工人;要提高中国制造的竞争力,必须着力培育 高素质的技术工人队伍。







管理 (Management)

- 电子工业是技术密集型产业。
- 现代化电子工业的精髓是科学的生产过程管理。

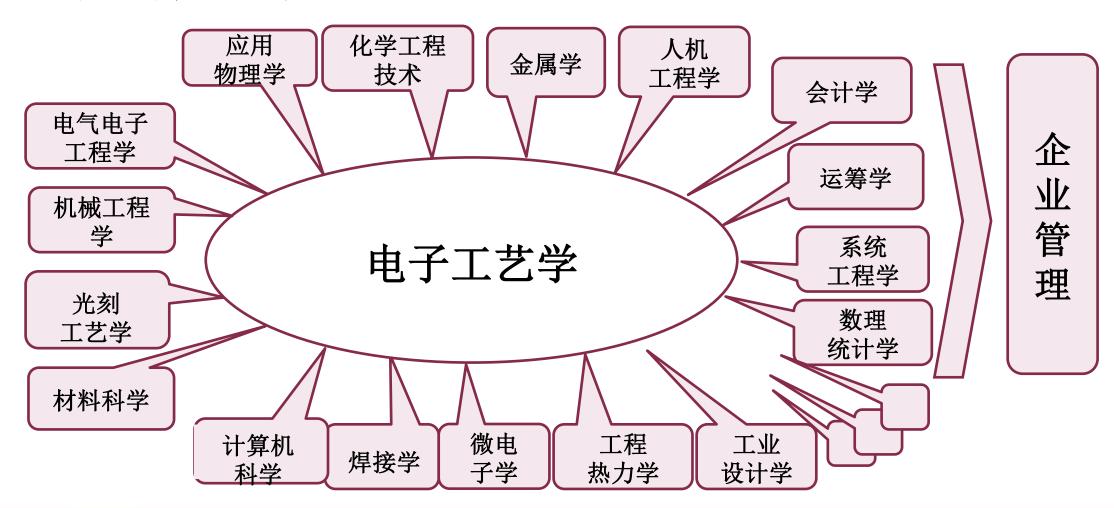
- 统计学、运筹学是现代管理科学的理论基础
- 电脑化、网络化的过程控制成为电子产品制造企业的管理体系
- 统一的、标准化的、完备的经济管理、技术管理和文件管理是现 代化企业运作的基本模式





1.2 电子工艺学的特点

1. 涉及众多科学技术领域







2. 形成时间较晚而发展迅速

1970s初步形成







1.3 电子工艺技术人员的工作范围

1.产品研发阶段的工作

(1) 参与产品研发,确保新产品的工艺性;

(2) 根据设计文件编制生产工艺文件、指导工人操作;

(3) 组织试制试产,解决生产中的技术难题;

(4) 编制设备、仪器的生产、测试规程,确保生产效率和质量。





2.生产阶段的工作

(1) 实施现场工艺规范和工艺纪律管理,培训和指导工人操作;

(2) 控制和改进产品质量。

3.企业发展阶段的工作

(1) 研讨、分析和引进新工艺、新设备,提高企业的工艺技术水平。





电子工艺技术培养目标:懂技术、会操作,能解决现场技术问题的工艺技术或现场技术可题的工艺技术或现场技术管理人才。





1.4 电子工艺技术发展历程

- (1) 早期——导线直连技术;
- (2) 最伟大的发明——印制电路;
- (3) 发展契机——晶体管的发明;
- (4) 起飞引擎——集成电路;
- (5) 大发展——通孔安装技术;
- (6) 现代化基础——元器件微型化;
- (7) 当前主流——表面贴装技术;





(1)早期电子管——导线直连技术

划时代意义:应用<u>导线直连技术</u>的电子管时代虽然很原始,但却开启电子工艺之先河。



1946年2月, 在宾夕法尼亚大学诞生

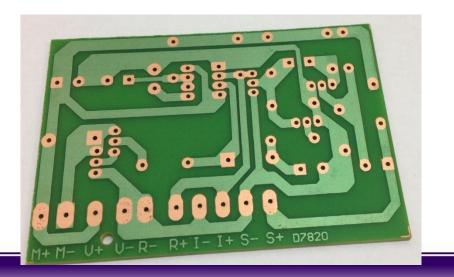
Engineering Training Center, Harbin Engineering University





(2)最伟大的发明——印制电路

- 20世纪50年代到80年代的30多年的主流技术
- 作用:元器件载体及其相互之间的连接;犹如住宅和道路对人类社会一样重要。
- 意义:使得电子产品的设计、装配走向标准化、规模化、机械化和自动化、体积减小,可靠性、稳定性高,装配和维修简单。

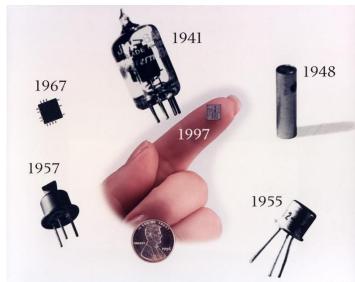






(3) 发展契机-晶体管的发明

• 1947年,贝尔实验室研制出第一个半导体三极管,开创了人类硅文明的时代。晶体管,没有玻璃管壳,不需要真空,体积很小,生产成本很低,它的寿命比电子管长得多。





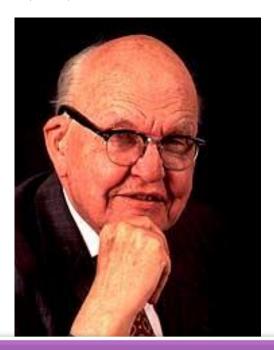
沃特·布拉顿 (Walter Brattain) 成 功地在贝尔实验室制 造出第一个晶体管。 **Engineering Training Center, Harbin Engineering University**





(4) 起飞引擎——集成电路

1958年9月12日,基尔比研制出世界上第一块集成电路,42年之后,他因为当年伟大的发明登上了诺贝尔物理学奖的领奖台。



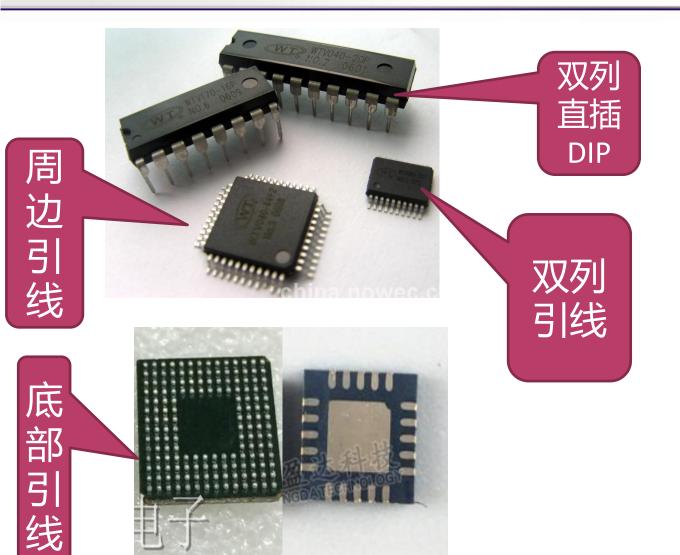


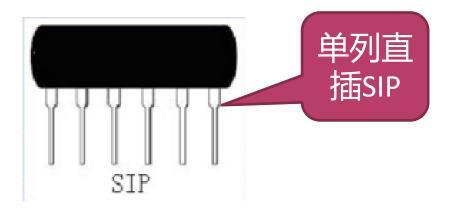
集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;

Engineering Training Center, Harbin Engineering University

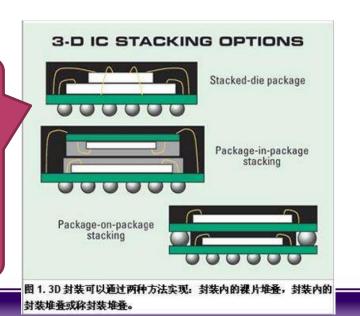








3D 封 装

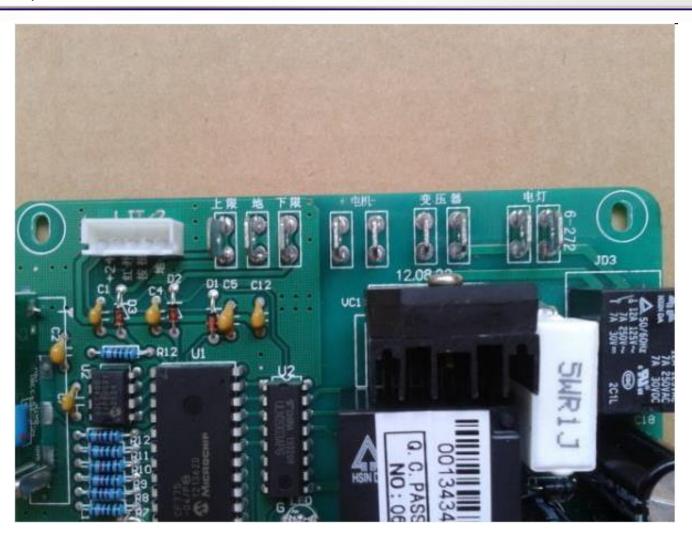






(5) 发展——通孔安装技术

- 20世纪50年代到 80年代,规模化 生产的初期的关 键组装技术
- 局限性
- 优点

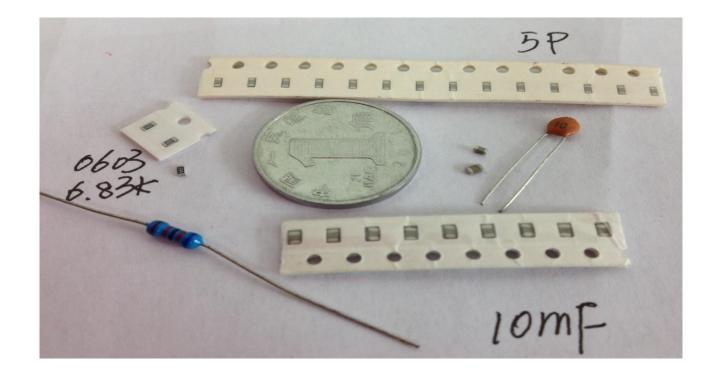






(6) 现代化基础——元器件微型化

• 20世纪80年代以来



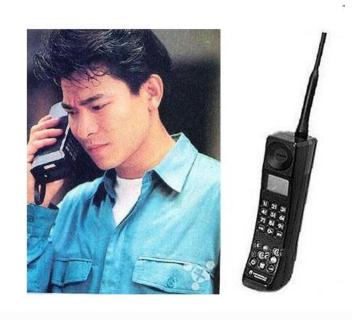
Engineering Training Center, Harbin Engineering University





(七) 当前主流一表面组装技术 SMT

- 发展: 20世纪70年代
- PCB上无需通孔,直接将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面 规定位置上的电路装联技术





哈尔滨工程大学工程训练中心

Engineering Training Center, Harbin Engineering University







火柴/蚂蚁













1.5电子信息产业在经济增长中的作用



汽车电子已经占据汽车总体成本的25%以上,高档轿车更是突破了50%.

2009年起, 我国成为全球汽车工业产销量第一, 并屡次刷新世界纪录。

| 年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 产量(万辆) | 8,974 | 9,078 | 9,497 | 9,730 |
| 销量 (万辆) | 8892 | 8970 | 9390 | 9680 |





2018年我国消费电子产品数据

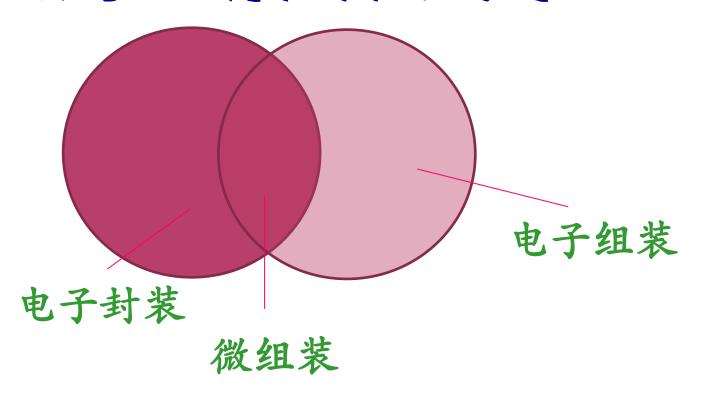
- 手 机:18亿部,占全球总产量的90%;
- 计算机: 3亿台, 占全球总产量的90%;
- 彩 电: 2亿台, 占全球总产量的70%。





1.6电子工艺的发展趋势

潮流一: 技术的融合与交汇







潮流二:绿色化

1、无铅(铅锡合金焊料 无铅焊料如锡银铜等)

欧洲、日本、美国的法案已经提出限制电子产品中铅的使用。

中国自2006年7月1日禁止电子产品中含有铅、汞、镉、六价铬、聚溴化联苯 (PBB)、聚溴化苯基 (PBDE)及其它有毒有害物质的含量。

大部分有机卤素化合物本身是有毒的,在人体中潜伏可导致癌症,且其生物降解率很低,致使其积累在生态系统中,而且部分挥发性有机卤素化合物对臭氧层有极大的破坏作用,对环境和人类健康造成严重影响。因此,被列为对人类和环境有害的化学品,禁止或限量使用,是世界各国重点控制的污染物。





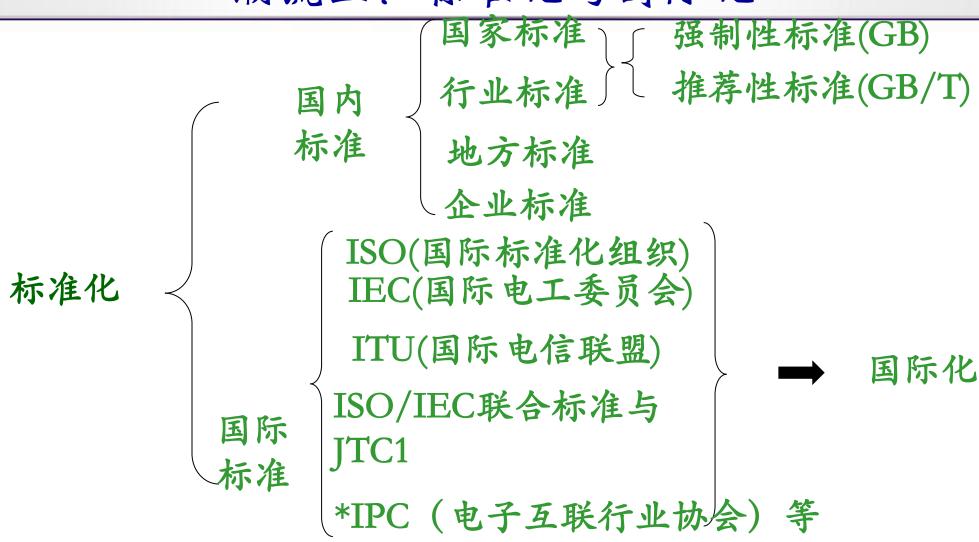
3.如绿色设计、能源效率、产品回收并大部分循环利用等方面。







潮流三:标准化与国际化







1.7电子工艺中的静电防护

1.静电放电及危害

静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷.

2. 静电的产生:

- (1)摩擦
- (2)感应
- (3)传导

| 环境湿度 | RH | RH |
|-----------------------|---------|---------------------|
| 人体活动 | 10-20% | 65-90% |
| 在地毯上走动 | 35,000V | 15,000V |
| 在已烯树脂地板上行走 | 12,000V | 250V |
| 在工作台上操作 | 6,000V | 100V |
| 包说明书的已烯树脂封皮 | 7,000V | 600V |
| 从工作台上拿普通塑料袋 | 20,000V | 1,200V |
| 从垫有聚氨基甲酸泡沫的 工作椅上站起 | 18,000V | o =7 1-590 % |





3.静电对电子元件的影响

1) 静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。

2) 因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作。(完全破坏)

3) 因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损





例如:静电对集成电路的影响

▶静电是引起集成电路及元器件内部击穿的主要方式。集成电路中CMOS器件耐击穿电压一般在80-100V,VMOS甚至低至20V。

▶随着集成度越来越高,集成电路特征尺寸越来越小,导线的宽度与间距也越来越小,所能承受的击穿电压更低。

▼ 电击感觉是由于人体静电瞬间释放造成的

| 人体带电量 | 电击程度 |
|---------|----------------|
| 1,000V | 完全没有感觉 |
| 3,000V | 感到刺痛 |
| 5,000V | 手掌甚至手腕感到发麻 |
| 7,000V | 手掌感到强烈疼痛、麻痹 |
| 10,000V | 整个手都觉得痛,并且感到触电 |
| 12,000V | 感到整个手受到强烈冲击 |



✓ 虽然人体感觉不到1,000伏以下的静电,可仍会成为 生产线上各种事故的原因

Engineering Training Center, Harbin Engineering University





4.静电防护方法

- 1、接地法:直接将静电通过一条线的连接泄放到大地。 方法实施:
 - 1) 人体通过手腕带接地。
 - 2) 人体通过防静电鞋(或鞋带)和防静电地板接地。
 - 3) 工作台面接地。
 - 4) 测试仪器,工具夹,烙铁接地。
 - 5) 防静电地板,地垫接地。
 - 6) 防静电转运车,箱,架尽可能接地。
 - 7) 防静电椅接地。





2. 静电屏蔽

静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响,最通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为保护。另外防静电衣对人体的衣服具有一定的屏蔽作用。

3. 离子中和

绝缘体往往是易产生静电,对绝缘体静电的消除,用接地方法是无效的,通常采用的方法是离子中和(部分采用屏蔽),即在工作环境中用离子风机等,提供一等电位的工作区域。